

1. Asigne los términos de la columna izquierda a las definiciones correspondientes a la derecha.

HDI	Es una mejora al formato de datos RS-274-D como una versión extendida.
Revestimiento conductor de la superficie	Proporciona la base para crear el patrón de circuito.
VIA	Es una conexión eléctrica entre capas en un circuito electrónico físico que atraviesa el plano de una o más capas adyacentes
RS-274X	Abreviatura utilizada para referirse a PCB de interconexión de alta densidad

2. Enumere tres características básicas de las placas de circuito impreso de interconexión de alta densidad.

1. _____
2. _____
3. _____

3. Corrija el texto para que las siguientes afirmaciones sean ciertas.

Los pines de la fuente de alimentación se deben desacoplar directamente del plano de tierra mediante el uso de (inductancias / condensadores cerámicos) lo más cerca posible de los pines de alimentación del circuito integrado.

En general, frecuencias superiores a 1GHz (1 GHz / 1 MHz) son consideradas altas frecuencias.

Los PCBs de una capa son fabricados de un sola capa de (material base o substrato / resina).

Las PCB con respaldo de aluminio: Aluminum backed PCBs, se componen de un refuerzo de (Au / Al) una capa dieléctrica altamente conductora térmicamente y una capa de circuito estándar.

Las PCB rigid-flex, combinan lo (peor / mejor) de las placas rígidas y flexibles integradas juntas.



El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación (comunicación) es responsabilidad exclusiva de su autor. La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.

4. Asigne los términos de la columna izquierda a las definiciones correspondientes a la derecha.

Floor plan	Se refiere a la leyenda blanca en el PCB que identifica los componentes, puntos de prueba.
Diseño Esquemático	Dibujo que indica la ubicación general de los componentes en el PCB.
DRC	Diagrama de un circuito electrónico en el software CAD.
Serigrafía (Silkscreen)	Es una función de software CAD que verifica si la PCB enrutada cumple con las reglas de diseño.

5. Enumere un mínimo de 5 pasos básicos del proceso de fabricación de PCB.

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____



6. Corrija el texto para que las siguientes afirmaciones sean ciertas.

Mantener las masas digitales y analógicas (juntas separadas) porque los picos de tensión y los de corriente desde circuitos (analógicos digitales) pueden generar ruido de interferencia en los circuitos (digitales analógicos).

Al ubicar los componentes, (minimizar maximizar) las distancias y evitar ángulos de (90 45) grados.

Los fabricantes utilizan un (ploter óptico impresora) para obtener una imagen (digital negativa) del PCB.

Las señales sensibles deben ser (mantenidas a parte blindadas) de las fuentes de ruido con planos y debe realizarse un control de impedancia.

